



产品特点

- 高导热率低界面热阻及良好触变性
- 无应力，可无限压缩至最薄0.1mm
- 无沉降、不流淌，可填充任何高低不平间隙
- 设计应用方便，配合自动点胶机可调节任意厚度尺寸
- 满足ROHS、REACH、UL等指令要求

典型应用

- CPU\GPU、晶闸管、晶片与散热片之间散热
- 汽车电子控制、驱动模块元器件与外壳之间的传热
- 网络设备、便携式电子装置、高端医疗器械等
- 新能源汽车电池、储能设备、热管散热模块等需热传导区域

使用说明

1. 将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹，灰尘和油污等。
2. 手动点胶，使用时需拧开嘴盖，接上混合管，再将胶管卡在AB胶枪的卡口，用力打胶，使A、B组分凝胶体混合均匀。将混合均匀的凝胶体点到对应位置，并等待凝胶体固化即可。
3. 自动化点胶，主要参照点胶机使用要求。
4. 固化时间受环境温度影响，温度越高固化越快。

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得，由于使用环境的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。跨越电子不担保销售产品和特定工况下使用跨越电子产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到什么问题，可以和跨越电子技术服务部门联系，我们将为您提供一切帮助。

技术参数

项目		单位	标准值		测试方法
基本参数	组分构成	/	A 组分	B 组分	/
	材质	/	陶瓷颗粒填充硅树脂		/
	颜色	/	草绿色	白色	目测
	比重	g/cc	2.8	2.8	ASTM D792
	挤出率 (90psi, 60s)	g/cm	25	25	/
操作性能	存放时间	月	6		/
	混合比例	kg	1:1		/
	常温固化 (25°C)	min	30~60		/
	高温固化 (100°C)	min	20		/
固化后参数	颜色	/	草绿色		目测
	硬度	Shore C	≤30		ASTM D2240
	使用温度范围	°C	-50~150		/
	UL 防火等级	/	V0		UL 94
	导热率	w/m.k	2.0±0.2		ASTM D5470
	体积电阻率	Ω.cm	≥2.0×10 ¹²		ASTM D257
	击穿电压	kV/mm	≥8.0		ASTM D149

注意事项

1. 防止未使用A、B组分凝胶体混合。点胶过程中，如果中途停止点胶时间过长，可能造成AB混合管内胶体变稠或固化，不易挤出。此时建议更换混合管。
2. 若不慎接触皮肤，擦拭干净，然后用清水冲洗；若不慎接触眼睛，立即用清水冲洗并到医院检查。
3. 安全性资料请参阅产品的 MSDS。

贮存要求

1. 本产品为无毒非危险品，按一般化学品搬运和运输即可
2. 使用后注意密封，储存于阴凉、干燥、通风处
3. 本产品密封储存保质期为6个月

包装规格

25+25CC/支, 50+50CC/支,
100+100CC/支, 200+200CC/支